公司代码：688591　　公司简称：泰凌微

泰凌微电子(上海)股份有限公司 2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本年度报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅本报告"第三节 管理层讨论与分析 四、风险因素"相关内容，请投资者予以关注。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是　√否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.66元(含税)。截至2026年3月31日，公司总股本240,743,536股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数4,242,687股后的股本236,500,849股为基数，以此计算合计拟派发现金红利62,909,225.83元(含税)，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的49.43%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份4,242,687股，不参与本次利润分配。

2、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司可参与本次分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

公司2025年度利润分配预案已经公司第二届董事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

母公司存在未弥补亏损

□适用　√不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用　√不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用　□不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	泰凌微	688591	不适用

1.2 公司存托凭证简况

□适用　√不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书
姓名	李鹏
联系地址	中国(上海)自由贸易试验区盛夏路61弄1号电梯楼层10层、11层(实际楼层9层、10层)
电话	021-50653177
传真	021-50653177
电子信箱	investors_relation@telink-semi.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

1、公司业务体系

(1)公司战略定位与业务演进

自成立以来，公司主要聚焦低功耗无线物联网芯片领域，在蓝牙、Zigbee、Thread、Matter等技术方向持续积累，形成了全球领先的低功耗多协议无线物联网能力，并在智能家居、人机交互、智能零售等多个细分市场建立了广泛的客户基础和领先的市场地位。

在人工智能技术快速向终端侧演进的背景下，物联网设备正由传统"连接节点"向"具备感知、计算与交互能力的智能节点"转变。终端设备不仅需要稳定可靠的无线连接能力，同时也需要在本地完成低功耗、高效率的数据处理与智能决策。

在此趋势下，公司正在从"低功耗无线物联网芯片供应商"，向"端侧AI智能节点核心芯片平台"升级，逐步构建"连接+计算+软件平台"的一体化能力体系：

· 在连接层面，公司持续强化多协议融合能力(蓝牙、Zigbee、Thread、Matter、WiFi、星闪等)，满足复杂多样的终端连接需求

· 在计算层面，公司推进端侧AI能力集成，实现语音处理、传感器数据分析等本地智能处理能力

· 在软件层面，公司提供从底层协议栈、边缘AI算法到应用参考设计的全栈解决方案，提升客户开发效率并增强生态粘性

通过上述能力的持续融合，公司产品正从"连接芯片"升级为"智能节点核心控制与通信平台"，在端侧AI时代具备更广阔的应用空间和更高的价值承载能力。

(2)公司增长驱动结构

为更清晰地呈现公司未来发展的动力来源，公司当前业务及未来增长可分为三个层次：

①基石层：稳定规模与现金流基础

公司在低功耗无线物联网领域具备深厚积累，蓝牙、Zigbee、Thread及Matter等产品在全球范围内实现规模化出货，并在智能家居、人机交互、智能零售等领域建立了稳固的领先市场地位。

该类业务具备以下特点：

· 市场需求稳定，应用场景广泛

· 出货规模大，是公司收入与现金流的重要基础

· 客户覆盖全球主流品牌厂商，具备较强的持续性

基石层业务为公司持续投入新技术与新产品提供了坚实基础。

②引擎层：驱动增长与结构升级

随着端侧AI应用逐步落地，公司在无线音频、边缘AI芯片等领域实现快速突破：

· 在无线音频领域，公司产品已进入专业音频设备、会议系统及消费类音频市场，并逐步从高端品牌向更广泛的客户层面渗透

· 在端侧AI芯片方面，公司TL721X、TL751X等系列产品已实现量产，支持智能语音处理、AI降噪等功能，广泛应用于高端音频应用等场景

该层业务具备以下特征：

· 单芯片价值量(ASP)显著高于传统芯片

· 毛利率水平相对更高

· 与AI应用结合紧密，具备较强成长性

引擎层业务是公司未来收入增长与盈利能力提升的核心驱动力。

③潜力层：打开长期增长空间

公司在汽车电子、医疗健康及新型人机交互等领域持续布局：

· 汽车领域：数字钥匙、胎压监测等项目推进顺利，预计未来逐步放量

· 医疗领域：与国内领先厂商合作，应用于连续血糖监测等低功耗场景

· 新兴领域：机器人、脑机接口等前沿应用具备长期潜力

该层业务当前规模较小，但具备以下特征：

· 高技术壁垒

· 长生命周期

· 高附加值

潜力层业务将为公司长期发展提供重要的增长空间和弹性。

2、公司主要业务情况

公司的主要业务是低功耗无线物联网芯片的研发、设计与销售，主要聚焦于低功耗蓝牙、双模蓝牙、Zigbee、Matter、WiFi等短距离无线通讯芯片产品，在私有2.4G芯片、无线音频芯片也有长期的技术积累和产品布局。近年来，随着人工智能(AI)的高速发展，AI算力在边缘设备的需求也快速增长，边缘AI设备不仅需要具备低功耗无线连接能力，而且对于本地的低功耗AI运算也提出新的要求，需要能够在本地高效处理各种外设和传感器收集到的数据，在保障高隐私可靠性的同时，能快速响应数据处理需求。在这一趋势下，公司进一步推进"AI+IOT"的产品战略，将边缘AI同低功耗无线物联网连接能力相结合，推出支持边缘AI技术的多个系列芯片和软件开发工具，公司业务进一步向边缘AI方向深化和拓展。公司正逐步形成"连接+端侧AI融合"的平台型能力，在物联网向智能化升级过程中占据独特的战略位置

公司在低功耗无线物联网芯片领域已处于全球第一梯队，其中在蓝牙、Zigbee及Thread等技术方向具备领先的市场份额与技术能力，公司与Nordic、Silicon Labs等国际厂商处于同一竞争梯队；公司产品布局也逐步在无线音频与端侧AI领域，WiFi系统级芯片与AI生态领域等方面不断完善。与单一技术路径厂商相比，公司具备以下差异化优势：

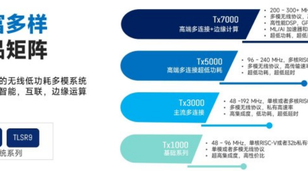
· 多协议融合能力：覆盖BLE、Zigbee、Thread、Matter及WiFi等多种通信技术

· 低功耗技术优势：在功耗控制方面具备长期积累

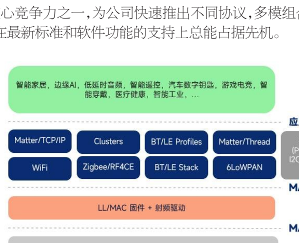
· 连接与AI融合能力：实现通信与本地计算能力的一体化设计。

3、公司主要产品情况

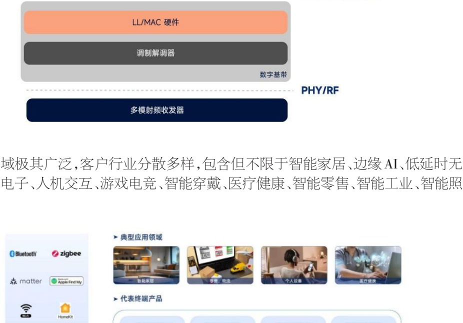
与公司的战略相匹配，公司的产品矩阵也更加丰富和完整，从传统的TLSR8，TLSR9系列，扩展到Tx1000～Tx7000等多个系列多个层次的产品组合，完整的覆盖了低功耗无线物联网多模连接，智能组网，边缘AI运算等多样化的需求。



公司在系统级芯片和硬件运算能力基础上，进一步为下游客户提供全栈式软件解决方案，从最底层的驱动固件，到多协议多模式的标准与私有协议栈，再到面向多样性应用的参考设计，大大减轻了下游客户开发负担，缩短开发时间，加速客户产品落地的节奏，同时也增加了客户的粘性。全栈式软件也形成了公司的核心竞争力之一，为公司快速推出不同协议，多模组合的灵活架构方案奠定了坚实的基础，也使得公司在最新标准和软件功能的支持上总能占据先机。

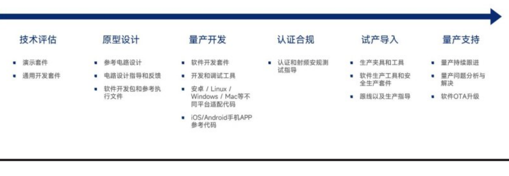


公司的产品领域极其广泛，客户行业分散多样，包含但不限于智能家居、边缘AI、低延时无线音频、智能遥控、汽车电子、人机交互、游戏电竞、智能穿戴、医疗健康、智能零售、智能工业、智能照明等领域。



公司的产品被大量国内外一线品牌所采用，包括以谷歌、亚马逊、小米等物联网为代表的生态系统企业以及其生态链企业，也包括不同垂直市场的头部企业，例如罗技、联想等一线计算机外设品牌，Vizio、创维、长虹、海尔等一线电视品牌，JBL、Sony等音频产品品牌，涂鸦智能、云鲸等智能家居品牌。和一线品牌客户的长期合作，体现了公司在产品性能上的领先性，以及产品的高品质和服务的高质量。公司基于和长期一线客户的路线图分享，进一步加深产品设计的深度和广度，构成了公司的竞争优势和商业壁垒。

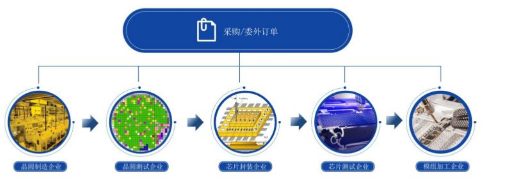
除了一线品牌生态企业和垂直行业头部品牌客户外，公司也积极布局长尾市场，建立了完善的在线文档系统、网络论坛、销售和代理网络，为中小型客户提供易上手、免支持的软硬件参考设计和产品，进一步增加了业务和服务对象的覆盖面。公司对于下游客户提供完善的服务和对接体系，从最初的接触和技术评估，到最终的量产支持和长期扶持，实行全生命流程一站式服务，与众多客户形成了长期的合作关系。



2.2 主要经营模式

公司专注于芯片的设计、研发和销售，采用行业通行的Fabless模式即无晶圆厂模式，将芯片制造环节外包给专业的晶圆代工厂商，封装测试环节则外包给专业的封装测试厂商。采用无晶圆厂模式，公司无需投入大量资金建设和维护制造工厂，大大降低了资金门槛和运营风险，能够集中优势资源投入到芯片设计研发中，有利于提高产品的技术含量和竞争力。通过与不同的代工厂商进行合作，公司还能根据自身需求灵活选择最合适的制造伙伴和工艺，提高生产效率，公司与多个海内外供应商维持良好的合作，确保了供应链的灵活性和弹性。

公司的芯片成品主要用于直接对外销售，部分芯片则委托模组厂商加工成模组，再对外销售。



2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司是一家专业的集成电路设计企业，主要从事无线物联网系统级芯片的研发、设计及销售。根据国家统计局发布的《战略性新兴产业分类(2018)》，公司属于"新一代信息技术产业"之"新兴软件和新型信息技术服务"之"集成电路设计"行业。

公司所属行业属于国家重点培育和发展的七大"战略性新兴产业"中的"新一代信息技术产业"，该行业作为现代信息产业的基础和核心产业之一，是支撑国民经济社会发展和保障国家安全的战略性、基础性和先导性产业，也是我国进口依存度大、亟需提升国产化水平的产业，因此受到国家多项法规政策的扶持鼓励，对国民经济健康发展具有重要的战略意义。

(一)行业发展阶段及基本特点

在过去数年里，以蓝牙、Zigbee、Thread、Matter和WiFi等为代表的短距离无线连接技术彻底改变了人类的生活，已经形成一个庞大并快速成长的互联设备生态系统。这些技术有些已经有20多年的历史，经历了重大变革和多次迭代，有些则是方兴未艾，但都显著提高了性能、效率、可靠性、安全性和可扩展性。以其中历史最为久远的蓝牙为例，该技术从上世纪末形成开始，已经从经典的以音频为中心的技术演变为低功耗、多连接形式的物联网(IoT)应用的领先无线技术，应用范围也从简单的无线连接，扩展到智能家居，工业物联，医疗健康，汽车网联等众多领域。

消费者和物联网应用的巨大多样性，使得单一技术无法满足每个市场的需求。这种演变导致短距离无线技术市场格局极其复杂，由于不同的可行技术各有优势，适用于不同消费者和商业场景，因此公司需要适应这些无线技术的发展趋势，推出支持相应技术功能的芯片和协议栈，以满足客户多样性的产品开发需求。

除此之外，随着人工智能和大数据的快速发展，无线物联网芯片行业进一步迎来了新的增长机遇。特别是在物联网和智能边缘AI设备领域，对高性能、低功耗芯片的需求不断增加。无线物联网芯片和边缘AI的发展也呈现出以下新特点：一是芯片制造工艺的持续进步，先进的工艺不断涌现，使得芯片性能大幅提升、功耗显著降低；二是全球芯片产业链的重塑，国际贸易摩擦和地缘政治因素导致供应链的多元化增加，推动相关产业的多元化和自主化发展；三是人工智能和机器学习技术的融合，为芯片设计带来了新的挑战和机会，芯片需要具备更强的计算能力和更高的能效比，以满足智能设备对实时数据处理的需求。四是端侧AI与无线连接的融合应用加速落地，音频、智能家居、工业等领域成为端侧AI芯片的核心落地场景，市场对低功耗、高算力的端侧AI芯片需求进入规模化增长阶段；五是以游戏、高端影音等为代表的消费电子领域对超高传输速率、超低延迟的无线连接技术提出更高要求，真8K无线传输、多设备音频同步成为技术发展新方向。

(二)技术门槛

(1)低功耗

在物联网无线连接设备和边缘设备中，功耗始终是最核心的指标之一，其中射频电流、睡眠电流、处理器效率等是关键挑战。从芯片设计的最初阶段就需要考虑降低功耗，通过优化电路结构以降低射频电流和睡眠电流，在兼顾性能的情况下提高处理器效率，以延长电池寿命。端侧AI运算的低功耗优化成为新核心难点，需在保证AI算法高效运行的前提下，实现芯片整体功耗的精准控制。

(2)射频性能和多模无线射频技术

发射功率、接收灵敏度、抗干扰性能是射频性能的关键指标。芯片需要在保持良好射频连接的同时，尽可能降低功耗，以满足物联网设备对长时间待机和稳定连接的需求。随着多种低功耗无线物联网技术的广泛应用，单个射频芯片需要支持多个不同的通信标准和协议，这对于无线收发机的设计也提出了更高要求，需要在有限的资源下满足多种无线通信发射和接收，保持低功耗和高性能。此外，高端消费电子场景对无线速率提出6Mbps及更高的要求，射频设计需兼顾高速率传输与低延时、低功耗的多重需求。

(3)高集成度

物联网设备由于其海量的需求对于系统的成本也较为敏感，同时在很多应用场景中，设备需要具有极小的面积/体积。芯片需要在尽可能小的尺寸内实现高度集成，以便吸收外部器件并增加新功能。这要求芯片设计具备良好的可扩展性和灵活性，能够满足不断变化的物联网应用需求。现阶段集成需求进一步升级，需在单芯片中融合双核处理器、AI加速模块、混合存储架构及丰富外设接口，同时适配不同设备的多样化封装需求。

(4)端到端超低延迟

在物联网应用中众多设备对于系统延时和响应速度具有苛刻的要求，满足毫秒级甚至是亚毫秒级延迟的需求是关键挑战。芯片需要综合考虑从最底层硬件到最上层软件的系统级优化，以实现端到端的超低延迟，从而提供快速响应的用户体验。真8K无线游戏、超低延迟音频、机器人控制、智能语音交互系统等场景对延迟的要求进一步严苛，需通过专用技术(如Telink HDT)实现极致的无线传输低延时。

(5)高复杂度的系统架构

随着产品的不断进步，芯片设计需要应对更复杂的系统级设计和架构。例如，多核架构的引入、异构计算的支持、边缘AI处理功能的添加以及芯片与软件的协同设计，都成为提升芯片性能和竞争力的重要手段。现阶段架构设计需兼顾RISC-V处理器、高性能DSP处理器、神经网络处理器(NPU)、图形处理器(GPU)等的高效协同，支持基于TensorFlow、PyTorch、ONNX等多种框架Edge AI模型的快速转换和部署，实现芯片与EdgeAI开发平台的深度协同。

(6)安全性和可靠性

安全性和可靠性已成为技术门槛的重要组成部分，特别是在物联网和智能设备中，芯片需要具备更强的抗攻击能力和数据保护机制，以应对日益复杂的安全威胁环境。系统级芯片和协议栈需要确保物联网设备和边缘AI计算设备满足高隐私、高可靠、高加密、可认证、可溯源的众多安全要求，从最核心的信任根(Root of Trust)到软件OTA的安全保护，需要芯片从硬件和软件多个层面具备安全功能。

(7)EdgeAI技术

随着边缘人工智能(EdgeAI)的兴起，芯片设计需要支持边缘计算和人工智能功能。这要求芯片具备更强的计算能力和更高的能效比，并集成专用的AI加速模块，以实现高效的数据处理和机器学习算法的运行。同时，EdgeAI还对芯片的实时性、低功耗和安全性提出了更高要求，以满足智能家居、智能办公、无线音频等领域的应用需求。现阶段EdgeAI技术门槛进一步提升，需实现本地AI交互的全流程落地，支持断网状态下的设备智能控制，同时保证AI模型移植的高效性，满足开发者快速开发的需求；此外，EdgeAI与Matter、蓝牙等协议的融合设计，成为跨场景应用的核心技术要求。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司在所处行业的多个领域拥有突出优势，地位稳固。公司的蓝牙低功耗系统级芯片长期位于市场的头部位置，成为全球第一梯队的代表之一。在Zigbee领域，公司是出货量最大的本土Zigbee芯片供应商，并稳居全球前列，在本地和国际市场上有强劲竞争实力。公司的Thread和Matter芯片紧跟最新的协议标准，在国际头部芯片供应商中占据一席之地。公司还在2.4G私有协议芯片领域取得领先地位，特别是在以无线和AI人机交互设备(HID)、智能零售电子货架标签(ESL)为代表的主要应用市场。在无线音频芯片方面，公司支持多种无线音频技术，包括最新的蓝牙低功耗音频技术，公司芯片已广泛应用于国际头部品牌的产品线。

在垂直应用市场中，公司建立了稳固的市场地位。在智能遥控器市场，公司芯片凭借多年的技术积累和市场验证占据了全球相当重要的份额；在智能零售电子货架标签(ESL)市场，公司提供高性价比的芯片和灵活的技术方案，出货量逐年增长，处于国内龙头地位；公司在细分无线音频产品领域具备独特的市场优势，特别是在超低延迟和多模共存音频设备方面。这些领域优势的叠加使得公司在无线低功耗物联网和边缘AI领域具备广泛的市场影响力和竞争实力。

近年来，随着芯片行业的快速发展和市场竞争的加剧，公司在技术创新和市场拓展方面取得了显著进展。一方面，公司积极布局新一代无线通信技术的研发，例如WiFi-6多模芯片、星闪(NearLink)多模芯片，进一步巩固了在物联网芯片领域的领先地位，2025年，公司完成支持星闪技术的多模低功耗物联网芯片流片。另一方面，公司紧跟EdgeAI技术的发展趋势，推出了多款支持边缘计算和人工智能的芯片产品如TL721X、TL751X系列等，这些产品凭借高性能、低功耗和强大的端侧数据处理能力，已在智能家居、智能办公和无线音频等领域得到广泛应用。2025年下半年，公司密集发布并落地多款芯片与模组产品：推出TC321X、TL321X两款全新低功耗物联网芯片，丰富产品矩阵，其中TL321 SoC主打高性价比，成为Matter over Thread领域的核心入门级产品，精准适配中小厂商智能家居设备的开发需求；同步发布ML7218X(含ML7218A、ML7218D)、ML3219D高性能物联网模组，并于2025年8月IOTE2025深圳物联网展首次亮相，ML7218X模组更斩获该展会"通信与定位产品"类别创新金奖，此外公司还推出Wi-Fi 6核心模组ML9118A，构建起多品类、全场景的模组产品布局。

同期，公司端侧AI芯片迎来放量出货，核心的TL721X系列芯片已实现量产，广泛应用于智能耳机、会议麦克风等音频领域，2026年该类芯片出货规模将跻身行业前列，且在智能家居、工业、健康、室内定位等领域的项目落地正持续推进。2026年1月，公司于CES(全球消费电子展)展出即将发布的突破性新品TL322X SoC，该芯片搭载双核处理器、集成Telink HDT技术，支持6Mbps无线速率，助力游戏外设迈入真8K无线时代，公司借此有望成为全球无线游戏解决方案的核心供应商之一。

随着蓝牙技术联盟中国实体于2025年3月中旬正式成立，联盟中的中国成员公司迎来了前所未有的发展机遇。公司作为行业先锋，一直深度参与蓝牙技术的演进，目前除在董事会扮演重要角色外，也积极参与联盟战略委员会、系统架构委员会和各重要工作组。公司技术团队也在多个标准发布前的互操作测试阶段中贡献了众多的成功测试用例。公司是全球少数最早提供量产级蓝牙Mesh组网解决方案的芯片设计公司，也是首批支持蓝牙低功耗音频、蓝牙角度定位和基于蓝牙的电子价签等芯片和协议栈功能的企业之一。公司的超低功耗蓝牙TL721X系列芯片、TLSR922X系列芯片和自研协议栈成功成为全球非手机芯片公司中首个获得蓝牙6.0认证的产品系列。公司的芯片布局也将持续紧密匹配蓝牙最新标准路线图，为下游客户提供丰富的选择。2025年上半年，蓝牙联盟发布6.1标准，公司第一时间完成6.1产品认证。2025年下半年，蓝牙技术联盟持续推出蓝牙超低延时(ULL)领域核心新标准，8月发布HID over ISO标准、11月发布作为蓝牙核心规范6.2核心特性的SCI(Shorter Connection Intervals)标准，大幅突破无线连接的延时与报点率上限。公司深度参与两项ULL新标准的制定与落地，全程参与联盟工作组相关工作并贡献专业技术意见，提前布局原型机开发并参与全球IOP测试，其中在HID over ISO领域贡献超50%的IOP测试结果，斩获蓝牙技术联盟HIDWG 2025年度"Outstanding IOP Contributor"奖章；在SCI标准制定中，多项技术意见被正式采纳，同时通过IOP测试获得蓝牙技术联盟"Recognition of IOP participation"认可，成为两项新标准的核心贡献企业。公司始终紧密匹配蓝牙技术联盟最新标准路线图，以技术前瞻布局持续夯实行业领先地位，为下游客户提供贴合市场需求的蓝牙芯片解决方案。

公司持续保持与国内外知名企业的合作，共同推动行业标准的制定和技术的普及，提升了其在全球芯片产业链中的影响力。通过技术创新与合作并举，公司持续巩固其在行业内的领先地位。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

2025年下半年蓝牙技术联盟接连推出HID over ISO、SCI两项ULL超低延时新标准，大幅提升无线连接的响应速度与报点率，公司深度参与这两项标准的制定与落地，凭借技术贡献斩获联盟多项认可。

针对Matter 1.5新标准，公司已完成核心协议栈升级，各型号芯片正按计划逐步实现新功能适配，并推出全系列Matter芯片方案：Matter over Thread领域，高端款TL721X搭载主频240MHzRISC-V MCU，简化版TL321X主打高性价比，TL323X专为低功耗电池供电传感器节点打造并提供最高4MB flash内存；Matter over Wi-Fi领域，TLSR9118支持Wi-Fi 6且无需边界路由器即可稳定连接，适配固件快速升级等高速传输场景；同时公司打造Matter+EdgeAI融合方案，基于TL-EdgeAI开发平台实现本地AI交互，解决云端延迟与隐私风险，且支持多模型快速移植，大幅提升开发者效率。

公司星闪多模芯片研发持续推进，后续将结合星闪2.0标准的商业化落地节奏，实现芯片的量产和市场推广，重点布局遥控器、键盘、鼠标等智能终端星闪技术核心应用场景。

公司端侧AI芯片进入放量出货阶段，核心应用于音频领域的TL721X系列芯片已实现规模化量产，其EdgeAI智能降噪方案成为行业标杆；2026年公司端侧AI芯片出货规模将实现大幅增长，智能家居、工业、健康、室内定位等领域的项目将逐步落地，成为公司新的业绩增长极；同时公司TL-EdgeAI开发平台支持LiteRT、TVM等多种AI模型，可转换TensorFlow、PyTorch、JAX等主流框架训练的模型，实现AI模型的快速移植，大幅降低开发者的应用门槛。

公司将RISC-V架构与EdgeAI、Matter 1.5、蓝牙6.2等新技术深度融合，TL721X搭载主频240MHz的RISC-V 32位MCU，并支持DSP扩展指令集，成为RISC-V架构在Edge AI领域的核心应用产品；2025年下半年发布的TL321 SoC及ML7218X、ML3219D模组均基于RISC-V架构打造，其中ML7218X搭载240MHz 32位RISC-V微控制器，ML3219D搭载96MHz 32位RISC-V微控制器，均支持DSP扩展指令，进一步夯实了公司在RISC-V开源芯片领域的技术优势；后续公司将持续基于RISC-V架构推出更多高算力、低功耗的芯片产品，覆盖游戏、智能汽车、工业物联网等应用领域，进一步强化在RISC-V开源芯片领域的领先地位。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元　币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	2,613,925,843.91	2,489,383,481.77	5.00	2,429,901,789.73
归属于上市公司股东的净资产	2,434,665,000.95	2,342,996,034.64	3.91	2,341,382,866.11
营业收入	1,015,027,035.49	844,033,021.15	20.26	636,091,867.00
利润总额	125,449,816.76	92,291,163.85	35.93	50,206,546.65
归属于上市公司股东的净利润	127,280,477.41	97,410,270.82	30.66	49,771,753.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	116,327,304.06	90,833,367.52	28.07	22,905,990.11
经营活动产生的现金流量净额	191,333,875.42	149,719,504.96	27.79	150,949,854.64
加权平均净资产收益率(%)	5.34	4.16	增加1.18个百分点	3.53
基本每股收益(元／股)	0.54	0.41	31.71	0.25
稀释每股收益(元／股)	0.53	0.41	29.27	0.25
研发投入占营业收入的比例(%)	27.17	26.06	增加1.11个百分点	27.16

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元　币种：人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	230,046,348.02	273,443,402.53	262,869,989.32	248,667,295.62
归属于上市公司股东的净利润	35,712,341.35	65,364,082.75	38,614,635.78	-12,410,582.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	34,084,133.85	58,964,255.53	36,308,237.43	-13,029,322.75
经营活动产生的现金流量净额	14,302,546.59	72,814,368.40	92,241,355.95	11,975,604.48

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	23,374
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	22,243

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
北京华胜天成科技股份有限公司	0	17,861,940	7.42	17,861,940	无		境内非国有法人
国家集成电路产业投资基金股份有限公司	-5,726,717	15,761,683	6.55		无		国有法人
上海芯狄克信息科技合伙企业(有限合伙)	0	14,530,320	6.04	14,530,320	无		境内非国有法人
上海芯析企业管理合伙企业(有限合伙)	0	12,885,300	5.35	12,885,300	无		境内非国有法人
盛文军	25,000	7,571,320	3.14	7,546,320	无		境内自然人
上海凌析微管理咨询合伙企业(有限合伙)	0	5,526,000	2.30	5,526,000	无		境内非国有法人
王维航	6,250	5,026,090	2.09	5,019,840	无		境内自然人
ZHENG MINGJIAN	25,000	4,740,820	1.97	4,715,820	无		境内自然人
上海浦东新兴产业投资有限公司	-2,077,090	4,198,610	1.74	0	无		国有法人
深圳市优尼科投资管理合伙企业(有限合伙)－深圳南山阿斯特创新股权投资基金合伙企业(有限合伙)	0	4,143,141	1.72	0	无		境内非国有法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	北京华胜天成科技股份有限公司、盛文军、上海凌析微管理咨询合伙企业(有限合伙)、ZHENG MINGJIAN以及未在前十大股东中列示的北京中域昭拓股权投资中心(有限合伙)、金海鹏为公司实际控制人王维航的一致行动人； 上海芯狄克信息科技合伙企业(有限合伙)、上海芯析企业管理合伙企业(有限合伙)为公司实际控制人王维航控制的企业。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

□适用　√不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

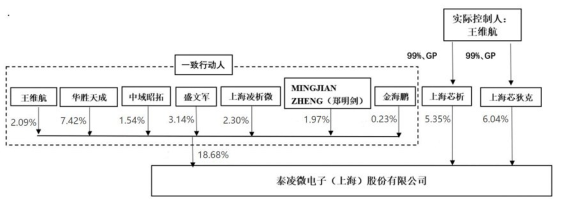
□适用　√不适用

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

□适用　√不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用　√不适用

5、公司债券情况

□适用　√不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入10.15亿元，同比增长20.26%；归属于上市公司股东的净利润1.27亿元，同比增长30.66%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.16亿元，同比增长28.07%；归属于上市公司股东的扣除股份支付影响后的净利润1.69亿元，同比增长53.68%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

证券代码：688591　　证券简称：泰凌微　　公告编号：2026-022

泰凌微电子(上海)股份有限公司关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。现将有关事项公告如下：

一、本次股权激励计划已履行的相关决策程序

1、2023年12月13日，公司召开第一届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相关议案发表了同意的独立意见。

同日，公司召开第一届监事会第十五次会议，审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》等议案，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

2、2023年12月14日，公司于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《泰凌微电子(上海)股份有限公司关于独立董事公开征集委托投票权的公告》(公告编号：2023-016)。根据公司其他独立董事的委托，独立董事刘宁女士作为征集人就公司2023年第一次临时股东大会审议的本激励计划相关议案向公司全体股东公开征集投票权。

3、2023年12月14日至2023年12月23日，公司对本激励计划首次授予激励对象名单在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到任何异议。2023年12月26日，公司披露了《监事会关于公司2023年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》(公告编号：2023-020)。

4、2023年12月29日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2023年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公司就内幕信息知情人在本激励计划草案公开披露前6个月内买卖公司股票的情况进行了自查，并于2023年12月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《泰凌微电子(上海)股份有限公司关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查报告》(公告编号：2023-025)。

5、2024年1月22日，公司召开第二届董事会第二次会议与第二届监事会第二次会议，均审议通过了《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司独立董事对前述议案发表了同意的独立意见。公司监事会对首次授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

6、2024年12月12日，公司召开第二届董事会第九次会议与第二届监事会第八次会议，均审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予预留限制性股票的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。公司监事会对预留授予日的激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。

7、2025年4月17日，公司召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并提请董事会审议。监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。

8、2026年4月8日，公司召开第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》《关于作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》《关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。董事会薪酬与考核委员会对本激励计划的相关事项进行核实并发表了相关核查意见。

二、本次作废处理限制性股票的原因和数量

根据公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》和《2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，作废处理首次授予部分因3名激励对象离职不得归属的限制性股票7.05万股、1名激励对象放弃本期归属的限制性股票0.88万股及因44名激励对象2025年个人层面绩效考核未达到"A、B+"不得归属的限制性股票2.31万股，合计作废限制性股票10.24万股。

作废处理预留授予部分因7名激励对象离职不得归属的限制性股票2.40万股、因11名激励对象2025年个人层面绩效考核未达到"A、B+"不得归属的限制性股票0.3531万股，合计作废限制性股票2.7531万股。

上述限制性股票共计作废12.9931万股，本次作废后，本激励计划首次授予激励对象由125人变更为122人，预留授予激励对象由33人变更为26人。

三、本次作废处理部分限制性股票对公司的影响

公司本次作废处理部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司核心团队的稳定性，不会影响公司股权激励计划继续实施。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废处理2023年限制性股票激励计划部分限制性股票符合有关法律、法规及公司《2023年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，董事会薪酬与考核委员会同意公司此次作废处理部分限制性股票。

五、法律意见书的结论性意见

律师认为，截至法律意见书出具之日：

(一)公司就本次调整、本次归属及本次作废已获得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及本激励计划的相关规定；

(二)本次调整事项符合《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及本激励计划的相关规定；

(三)本次归属的归属条件已经成就，符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及本激励计划的相关规定；

(四)本次作废符合《上市公司股权激励管理办法》及本激励计划的相关规定。

公司尚需按照相关法律、法规、规范性文件的规定履行相应的信息披露义务。

六、备查文件

1、泰凌微电子(上海)股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议

2、泰凌微电子(上海)股份有限公司第二届董事会薪酬与考核委员会第十一次会议决议

3、北京市中伦(上海)律师事务所关于泰凌微电子(上海)股份有限公司2023年限制性股票激励计划授予价格调整、归属期归属条件成就及部分限制性股票作废相关事项的法律意见书

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：688591　　证券简称：泰凌微　　公告编号：2026-019

泰凌微电子(上海)股份有限公司关于申请银行授信额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月8日召开了第二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于申请银行授信额度的议案》。现将相关事项公告如下：

为满足公司生产经营和业务发展的需要，公司及子公司拟向银行申请总额不超过人民币12亿元的授信额度，授信业务包括但不限于贸易融资、流动资金贷款、商业汇票、信用证、固定资产贷款、票据贴现、票据质押贷款、存款质押贷款、并购贷款、项目贷款等，具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。该综合授信事项有效期为自董事会审议通过之日起12个月，在授信期限内，授信额度可循环使用，可以在不同银行间进行调整，无需公司另行审议。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资总金额应在授信额度内，并以银行与公司实际签署的协议为准，具体融资金额及品种将视公司业务发展的实际需求来合理确定。

公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人在上述额度内与银行签署相关合同及法律文件，并授权财务部办理相关手续。

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：688591　　证券简称：泰凌微　　公告编号：2026-015

泰凌微电子(上海)股份有限公司 2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例及每股转增比例：每10股派发现金红利2.66元(含税)，不送红股，不进行资本公积转增股本。

● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 如在实施权益分派的股权登记日前公司可参与本次分配的总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称《上市规则》)第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配预案内容

(一)利润分配预案的具体内容

经安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为127,280,477.41元，截至2025年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为306,870,886.92元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

1、公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.66元(含税)。截至2026年3月31日，公司总股本240,743,536股，以扣除公司回购专用证券账户中股份数4,242,687股后的股本236,500,849股为基数，以此计算合计拟派发现金红利62,909,225.83元(含税)，占2025年度合并报表归属于上市公司股东净利润的49.43%。

本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元，现金分红和回购金额合计62,909,225.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.43%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元，现金分红和回购并注销金额合计62,909,225.83元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例49.43%。

公司通过回购专用账户所持有本公司股份4,242,687股，不参与本次利润分配。

2、本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。如在本预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司可参与本次分配的总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

公司未触及《上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。具体情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	62,909,225.83	48,482,674.05	-
回购注销总额(元)	0	0	-
归属于上市公司股东的净利润(元)	127,280,477.41	97,410,270.82	-
母公司报表本年度末累计未分配利润(元)	306,870,886.92		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	111,391,899.88		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	112,345,374.12		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	111,391,899.88		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于3000万元	否		
现金分红比例(%)	99.15		
现金分红比例是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额(元)	495,793,018.34		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	是		
最近三个会计年度累计营业收入(元)	1,859,060,056.64		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例(%)	26.67		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例是否在15%以上	是		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：公司于2023年8月25日在上海证券交易所科创板上市，未满三个完整会计年度，根据《上市规则》第12.9.1条"公司上市不满三个完整会计年度的，最近三个会计年度以公司上市后的首个完整会计年度作为首个起算年度"，故上表中"最近三个会计年度"系指2024、2025年度。

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月8日召开第二届董事会第十九次会议，全体董事一致审议通过了《关于公司2025年度利润分配预案的议案》，并同意将本议案提交股东会审议。本预案符合公司章程规定的利润分配政策。

三、相关风险提示

(一)现金分红对公司现金流状况、生产经营的影响分析

本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

(二)其他风险说明

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：688591　　证券简称：泰凌微　　公告编号：2026-018

泰凌微电子(上海)股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

● 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)(简称"安永华明")

● 本次事项尚需提交泰凌微电子(上海)股份有限公司(简称"公司")股东会审议。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1、基本信息

安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)于1992年9月成立，2012年8月完成本土化转制，从一家中外合作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华明总部设在北京，注册地址为北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室。截至2025年末拥有合伙人249人，首席合伙人为毛鞍宁先生。安永华明一直以来注重人才培养，截至2025年末拥有执业注册会计师逾1700人，其中拥有证券相关业务服务经验的执业注册会计师超过1500人，注册会计师中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师逾550人。安永华明2024年度经审计的业务总收入人民币57.10亿元，其中，审计业务收入人民币54.57亿元，证券业务收入人民币23.69亿元。2024年度A股上市公司年报审计客户共计155家，收费总额人民币11.89亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业、金融业、批发和零售业、采矿业、信息传输、软件和信息技术服务业等。本公司同行业上市公司审计客户13家。

2、投资者保护能力

安永华明具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险，保险涵盖北京总所和全部分所。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币2亿元。安永华明近三年不存在任何因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

安永华明近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施3次、自律监管措施1次、纪律处分0次。19名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施4次、自律监管措施2次、行业惩戒1次和纪律处分0次；2名从业人员近三年因个人行为受到行政监管措施各1次，不涉及审计项目的执业质量。根据相关法律法规的规定，上述事项不影响安永华明继续承接或执行证券服务业务和其他业务。

(二)项目成员信息

1、基本信息

项目合伙人和第一签字注册会计师周浩先生，于2015年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、2011年开始在安永华明执业、2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署2家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括制造业及计算机、通信和其他电子制造业等行业。

第二签字注册会计师王丽红女士，于2015年成为注册会计师、2010年开始从事上市公司审计、2010年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署3家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子制造业等行业。

质量控制复核人徐汝洁女士，于2000年成为注册会计师、2011年开始从事上市公司审计、1993年开始在安永华明执业、2024年开始为本公司提供审计服务；近三年签署/复核4家上市公司年报/内控审计，涉及的行业包括计算机、通信和其他电子制造业等行业。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，或受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

安永华明及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师独立性准则第1号》和《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2025年度审计收费为人民币188万元(含2025年度内控审计费用40万元)。审计收费定价主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与审计工作人员的经验、级别及相应的收费率以及投入的工作时间等因素确定。公司董事会将提请股东会授权经营管理层根据2026年公司审计工作业务量及市场价格水平，与安永华明协商确定2026年度审计费用。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)审计委员会的审议意见

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，认为：公司本次续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。拟聘任的安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)具备《证券法》规定的执业资质，拥有丰富的上市公司审计服务经验，其专业胜任能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况均能满足公司财务审计与内控审计的需求，续聘理由充分、恰当。审计委员会一致同意续聘安永华明为公司2026年度财务报告审计机构与内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，全体董事一致同意聘任安永华明为公司2026年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议通过，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会
2026年4月10日

证券代码：688591　　证券简称：泰凌微　　公告编号：2026-029

泰凌微电子(上海)股份有限公司关于延期回复《关于泰凌微电子(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

泰凌微电子(上海)股份有限公司(以下简称"公司")拟通过发行股份及支付现金的方式购买上海磐启微电子有限公司100%股权，并募集配套资金(以下简称"本次交易")。本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易，不构成重组上市。

公司于2026年3月9日收到上海证券交易所下发的《关于泰凌微电子(上海)股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金申请的审核问询函》(上证科审(并购重组)〔2026〕11号)(以下简称"《审核问询函》")。根据《审核问询函》的要求，公司回复审核问询的时间总计不得超过1个月。如难以在前述时间内回复的，可以按照《上海证券交易所上市公司重大资产重组审核规则》的规定，向上海证券交易所申请延期一次，时间不得超过1个月。

公司在收到《审核问询函》后，立即组织本次交易相关中介机构进行了逐项核实和答复。鉴于《审核问询函》涉及的部分事项还需进一步落实，相关事项的完成所需工作时间较长，预计无法在规定时间内向上海证券交易所提交完整的书面回复及相关文件。为切实稳妥做好《审核问询函》回复等相关工作，经与本次交易的各方及有关中介机构审慎协商，公司已向上海证券交易所提交延期回复的书面申请，申请自《审核问询函》回复期届满之日起延期不超过1个月提交《审核问询函》回复等相关文件，并及时履行信息披露义务。

本次交易尚需满足多项条件后方可实施，包括但不限于上海证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会同意注册等。本次交易能否取得上述批准和注册，以及最终取得审核通过和同意注册的时间均存在不确定性。公司将继续推进本次交易的相关工作，并根据本次交易的进展情况严格按照有关法律法规的要求履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

泰凌微电子(上海)股份有限公司董事会
2026年4月10日